



2025年3月6日

各位

会社名 株式会社RS Technologies
代表者名 代表取締役社長 方 永義
コード番号 3445 東証プライム市場
問合せ先 経営企画室長 田淵 勝也
電話 03-5709-7685

2024年12月期 決算説明会動画及び書き起こし公開のお知らせ

当社は、2025年2月21日に開催しました2024年12月期決算説明会に関するアーカイブ動画及び書き起こしを下記のとおり公開いたしました。

本説明会では、2024年12月期の決算概況、中期経営計画及び新規事業等についてご説明した後、お寄せいただいたご質問にお答えいたしました。株主・投資家の皆様におかれましては、ぜひご覧いただけますと幸いです。

記

1. 決算説明会概要

開催日時：2025年2月21日

説明者：代表取締役社長 方 永義
取締役上席執行役員 遠藤 智
財務経理部長 河路 将人

2. 資料格納先

アーカイブ動画：

<https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/MTYxNQ%3d%3d%23NDkwNA%3d%3d%23500%232d0%230%233FE2F9D5E400%23NzphOmY7MTA7MTA7MTA%3d%23>

決算説明資料：

<https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS02916/1737ac97/8c14/4cc4/a31a/784e8a4b0bf7/140120250214576832.pdf>

以上

2024年12月期

決算説明資料



株式会社 RS Technologies プライム市場 3445

2025年2月14日

COPYRIGHT © RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

方：本日は当社の2024年12月期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。
代表取締役社長の方永義と申します。
早速ですが説明をはじめさせていただきます。
決算概要、中期経営計画、新規事業については、取締役の遠藤よりご説明差し上げます。

遠藤：遠藤と申します。
本日はご参加いただきありがとうございます。
説明の最後に質疑応答もさせていただきますので、ご不明な点は後ほどご質問ください。

2024年12月期 決算概要

01

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

それでは説明をはじめます。

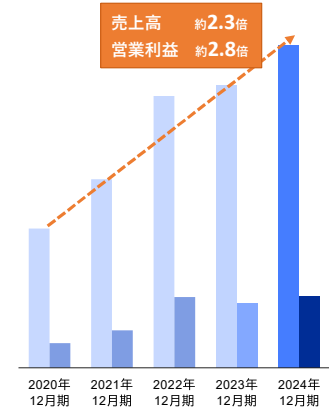
業績サマリー/事業環境



売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
59,200 百万円 前年比 +14.0%	13,108 百万円 前年比 +10.2%	15,668 百万円 前年比 +5.0%	9,446 百万円 前年比 +22.6%

・2024年12月期は、**連結売上高・営業利益は過去最高を記録**

	事業環境
ウェーハ再生事業	半導体業界の成長を背景に、事業環境は良好。国内外の新工場からの需要も取り込み2024年増産投資効果後も三本木、台湾工場ともにフル稼働。
プライムウェーハ事業	Gritekの主力商品8インチパワー半導体は、中国半導体市況の影響受けにくい商品構成だが、2024年からの中国半導体市況回復は追い風となった。2024年増産投資後もフル稼働、需要増加により2025年の増産投資はすでに準備を開始。
半導体関連装置・部材等事業関連	2024年下期からは、半導体製造装置市況回復を背景に、DG Technologiesの需要が回復基調となった。商社機能は、月によって差はあるものの通期の売上高は前年比微増。セグメント全体としては、第1四半期のバルクセルの特需もあり売上高は増加。
その他	親会社株主に帰属する当期純利益は、艾索精密部件(惠州)有限公司(略称、RSPDH)の株式取得に伴う負ののれん15億円を特別利益として計上。



COPYRIGHT © RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

まず業績サマリーと事業環境についてです。
連結業績は全ての利益段階で前年を上回り過去最高収益を更新いたしました。

ウェーハ再生事業の事業環境は、半導体市場の成長を背景に三本木工場、台湾工場ともに良好で、増産投資後も常にフル稼働で操業している状況です。

プライムウェーハ事業は、中国にてプライムウェーハの製造販売を行っております。当社の主力商品である8インチウェーハは市況環境の影響を受けにくく、高い利益率も維持しやすいといえます。ただ、2024年の中国半導体市況回復の影響は、当社事業環境に少なからず追い風になりました。

半導体関連装置・部材等事業は、主に商社ビジネスとDGテクノロジーのエッチング装置向け消耗部材の製造販売で構成されております。
商社ビジネスの事業環境としては、半導体市況の回復基調を背景に、前年に比べ半導体検査装置の売上高が好調に推移いたしました。
DGテクノロジーに関しても、同様に需要が回復基調となっております。

その他、親会社株主に帰属する当期純利益が94億4600万円、前年比22.6%と大幅に伸長した要因の1つとして、艾索精密部件(惠州)有限公司、略称RSPDHの株式取得に伴う負ののれん約15億円を特別利益として計上したことがあげられます。

過去のコロナ渦の特需で業績が大きく伸長しましたが、その後も堅調に成長を続けております。

2024年12月期決算概況



・売上高は、前年同期比14.0%増の59,200百万円、営業利益は、前年同期比10.2%増の13,108百万円となった

(百万円)

	2023年12月期	2024年12月期	前年比	差額
売上高	51,893	59,200	+14.0%	+7,307
営業利益	11,894	13,108	+10.2%	+1,259
営業利益率	22.9%	22.1%		△0.8pt
経常利益	14,921	15,668	+5.0%	+747
経常利益率	28.7%	26.4%		△2.3pt
親会社株主に帰属する 当期純利益	7,703	9,446	+22.6%	+1,743
一株当たり当期純利益	292.76円	358.21円	+22.3%	+65.45円

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

2024年12月期の決算概況を説明します。

売上高は前年比14%増の592億円、営業利益は前年比10.2%増の131億800万円、経常利益は前年比5%増の156億6800万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前年比22.6%増の94億4600万円と増収増益で着地いたしました。

2024年12月期 セグメント動向



- ・ウエーハ再生事業は、三本木及び台湾工場にて増産設備投資により出荷数量が増加し、前年比増収増益で推移
- ・プライムウエーハ事業は、増産投資効果により8インチプライムウエーハの生産・出荷数量が増加
- ・半導体関連装置・部材等事業は、第1四半期の大口案件の影響もあり前年比増収

(百万円)

	ウエーハ再生事業		プライムウエーハ 製造販売事業		半導体関連装置・ 部材等事業		その他、調整額		連結合計	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
売上高	23,794	+16.0%	20,443	+9.1%	16,283	+15.8%	△1,320	—	59,200	+14.0%
営業利益	9,059	+11.6%	4,743	+26.7%	884	+0.2%	△1,578	—	13,108	+10.2%
営業利益率	38.0%	△1.5pt	23.2%	+3.3pt	5.4%	△0.8pt	—	—	22.1%	△0.8pt

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

ウエーハ再生事業は売上高、営業利益ともに堅調に推移いたしました。

営業利益率は前年比で1.5pt減少しておりますが、その要因の1つとして、前年下期は利益率の高い販売ウエーハの割合が多く非常に利益率が高かったことがあげられます。売上構成による多少の変動はあるものの今後も高い利益率は維持していきたいと考えております。

プライムウエーハ事業は、2024年から中国半導体市況が回復してきたことが追い風になりました。営業利益率は、原材料調達戦略や歩留まり改善の取り組みにより前年比3.3ptの改善となりました。

半導体関連装置・部材等事業は、第1四半期の大口スポット案件の影響もあり、前年比15.8%増と大幅増収となりました。

半導体装置市況の回復を背景にDGテクノロジーズの業績も回復基調となりました。

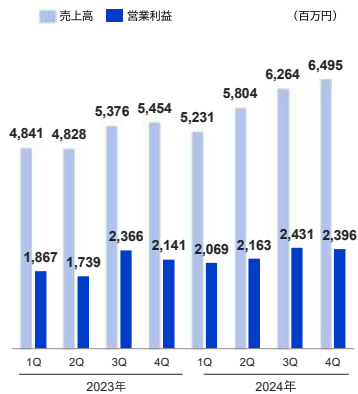
商社機能では、下期に子会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの特定商材の売上高減少がありました。半導体検査装置など他の商材でカバーし、売上高、営業利益ともに増収増益で着地いたしました。

2024年12月期 セグメント別動向 四半期実績グラフ

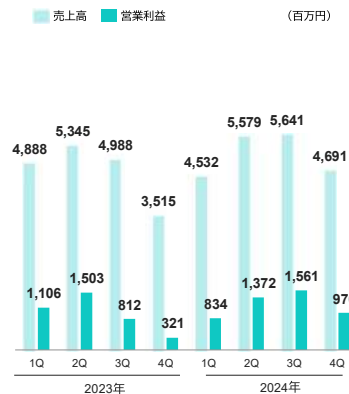


- ウェーハ再生事業は、増産投資効果により出荷数量が前四半期と比較し増加
- プライムウェーハ事業は、シリコン部材の市場調整により売上高が減少
- 半導体関連装置・部材等事業は、半導体市況回復を背景に、検査装置販売が前四半期比増収増益となった

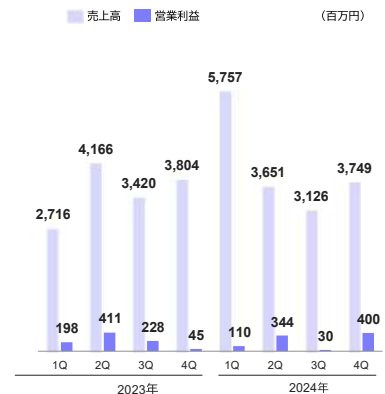
ウェーハ再生事業



プライムウェーハ事業



半導体関連装置・部材等事業



COPYRIGHT © RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

セグメント別の四半期実績です。

ウェーハ再生事業の第4四半期は、増産投資による出荷枚数増加と再生、販売ウェーハの売上MIXにより増収となりました。

日本やアメリカの半導体新工場からの需要もしっかりと取り込むことができました。

プライムウェーハ事業の第4四半期は、お客様のシリコン部材の在庫調整があり第3四半期比減収となりました。

半導体関連装置・部材等事業の第4四半期は、商社機能の半導体検査装置販売の売上高、営業利益が好調に推移いたしました。

貸借対照表



・純資産は、前年期末比201億円増の1,355億円(前年1,154億円)となった

(百万円)

連結貸借対照表	2023年12月期	2024年12月期
流動資産	96,409	124,894
現金及び預金	70,758	85,224
受取手形及び売掛金	12,673	23,417
商品及び製品	6,507	6,678
固定資産	44,256	57,252
有形固定資産	35,326	45,575
無形固定資産	266	689
投資その他資産	8,663	10,987
資産合計	140,666	182,146
流動負債	18,265	34,804
支払手形及び買掛金	5,174	8,302
有利子負債	3,355	8,754
固定負債	6,973	11,794
長期借入金	2,092	734
負債合計	25,238	46,598
純資産	115,428	135,548
負債・純資産合計	140,666	182,146

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

貸借対照表です。
純資産は、前年期末比201億円増の1,355億円となっております。

中期経営計画

02

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

続きまして、中期経営計画についてご説明いたします。

中期経営計画 (2025-2027)



- 半導体市場の成長に伴い、当社は、引き続き主要事業(再生ウェーハ & プライムウェーハ事業)を中心に、継続的な設備投資を実施し、収益性及び効率性の向上を図る

	(百万円)	2023年 12月期 (実績)	2024年 12月期 (実績)	2025年 12月期予算	2026年 12月期予算	2027年 12月期予算
収益性	売上高	51,893	59,200	75,000	88,000	100,000
	営業利益	11,894	13,108	15,100	17,700	21,900
	営業利益率	22.9%	22.1%	20.1%	20.1%	21.9%
	経常利益	14,921	15,668	16,600	19,200	23,400
	経常利益率	28.8%	26.4%	22.1%	21.8%	23.4%
	親会社に帰属する当期純利益	7,703	9,446	8,760	10,270	12,700
効率性	ROIC	14.1%	12.5%	13%以上		
	ROE	13.7%	13.8%	14%以上		

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

中期経営計画の数値目標です。

2025年12月期は売上高750億円、営業利益151億円、経常利益166億円、親会社に帰属する当期純利益87億6,000万円を計画しております。

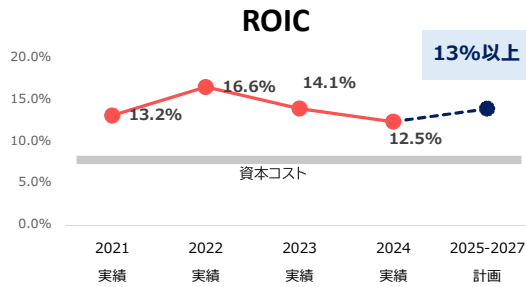
2027年12月期には売上高1,000億円、営業利益219億円を目指しております。

資本コストについて

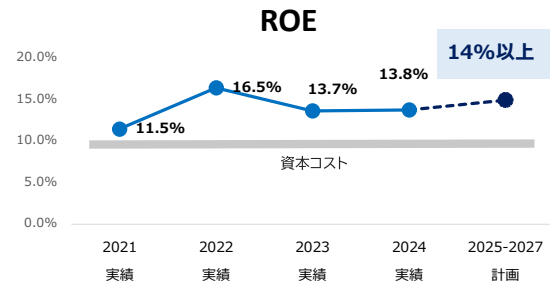


- ・当社連結ROIC及びROEは、CAPMベースの資本コストに対し継続して超過しており良好
- ・2025年～2027年でROIC13%以上、ROE14%以上を計画

資本利益率



*ROIC= NOPAT÷投下資本 (株主資本+有利子負債)



*ROE= 親会社に帰属する当期純利益÷自己資本

資本コスト

当社 WACC	9.0 %
---------	-------

*WACC=株主資本コスト×株主資本/(投下資本)+負債コスト×有利子負債/(投下資本)×(1-実効税率)から当社過去2年の平均値で算出

当社 株主資本コスト	10.5 %
------------	--------

*株主資本コスト (2024年)=
リスクフリーレート(1.11%) + ベータ値(1.6)×リスクプレミアム(6%)=10.7%
当社2023年株主資本コスト=10.2%より過去2年の平均値で10.5%を算出

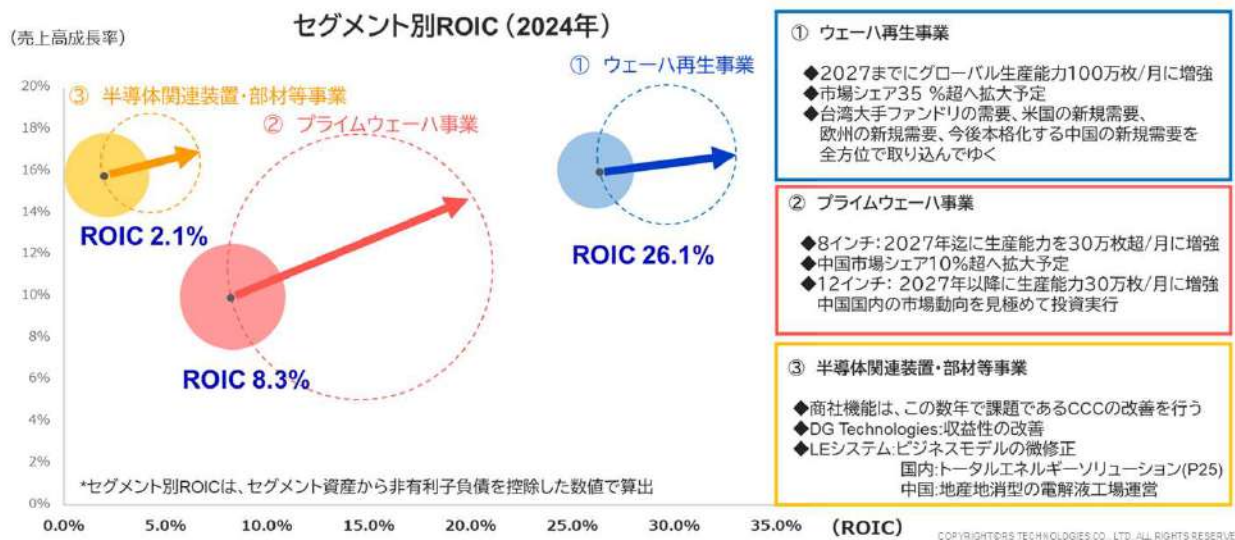
COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

続いて、資本コスト関連の現状認識です。ROICは、下降傾向にあるように見えます。これは、収益性は非常に高いが、市場規模が限定的である再生ウェーハ事業をキャッシュカウとし、2兆円市場であるプライムウェーハ事業に参入していることに起因します。2024年12月期のROEが前年比で上昇している理由は、RSPDH買収による負ののれん約15億円が親会社に帰属する当期純利益に加算されたことが要因となります。2025年12月期以降はROIC13%以上、ROE14%以上を計画しております。WACCは9%、資本コストは10.5%となっております。それぞれの計算式は、資料掲載の通りです。

主力セグメント動向



- ・ ウェーハ再生事業は、高収益体質の事業を確立
- ・ プライムウェーハ事業は、中国12インチへの投資を本格化し規模・収益拡大を計画



セグメント別の動向です。

まず、ウェーハ再生事業です。こちらは台湾大手ファウンドリはじめとする強い需要がございます。中国の動向を見極めながら2027年までにグローバルで月産100万枚の体制を構築します。欧州や中国の新規需要も獲得してまいります。

次にプライムウェーハ事業です。

中国の景気動向に若干の影響を受ける事業ではございますが、8インチパワー半導体、特に低抵抗の分野で底堅い需要を獲得しています。

2027年からは月産30万枚を超える体制を目指す予定です。

12インチ事業、こちらは持分法適用子会社となりますが2027年以降に月産30万枚の生産体制を目指します。

半導体関連装置・部材等事業は、近年の課題であるCCCの改善を行います。

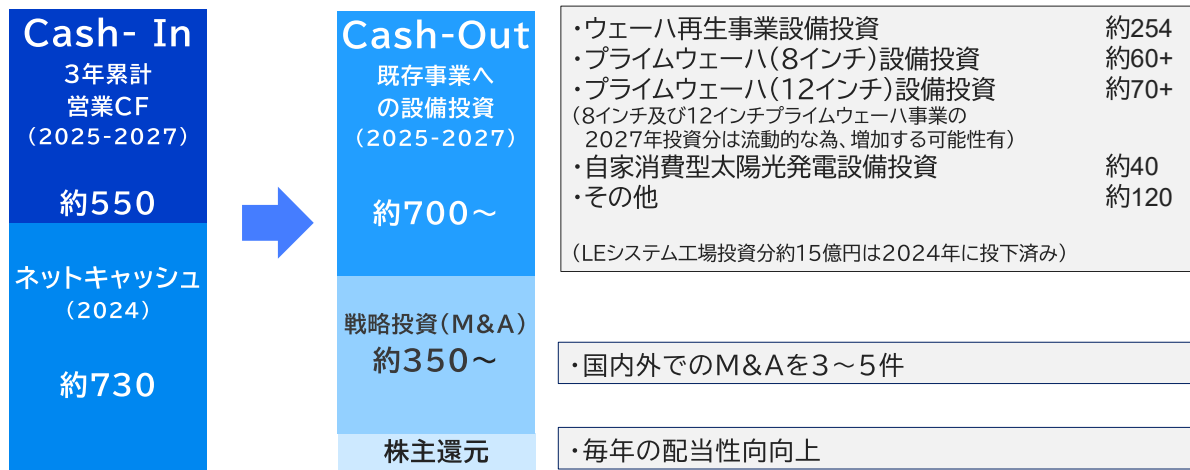
また、LEシステムはビジネスモデルを微修正し、日本国内でトータルエネルギーソリューションカンパニーとしてプランを増やします。中国では地産地消型の電解液工場の立ち上げを行います。

キャッシュ・アロケーション（3か年累計）



・3か年累計のCash-In約550億円とネットキャッシュ約730億円を設備投資とM&Aに活用する

単位（億円）



COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

各事業の投資については後ほどご説明しますが、3か年累計で、700億円程度を設備投資、350億円程度をM&Aに用いる計画です。

設備投資計画:ウェーハ再生事業



- 世界の半導体需要が拡大する中、日本・台湾での増産、及び、中国山東省において量産準備中
- 旺盛な需要に対応すべく、2027年までに月産100万枚超の生産能力を確立予定

日本 

総投資額

128億円

2025年度	2026年度	2027年度
13億円	15億円	100億円

- 12インチ再生ウェーハの生産能力拡充及び微細化対応
- 2025~2027年:月産+12万枚能力増

■ 12インチ再生ウェーハ生産能力(月産)

2024年	2025年	2026年	2027年
32万枚	34万枚	36万枚	44万枚

台湾 

総投資額

61億円

2025年度	2026年度	2027年度
21億円	28億円	12億円

- 12インチ再生ウェーハの生産能力拡充及び微細化対応
- 2025~2027年:月産+10万枚能力増

■ 12インチ再生ウェーハ生産能力(月産)

2024年	2025年	2026年	2027年
27万枚	29万枚	33万枚	37万枚

中国 

総投資額

65億円

2025年度	2026年度	2027年度
5億円	30億円	30億円

- 12インチ再生ウェーハ生産能力拡充
- 2025~2027年:月産+15万枚能力増

■ 12インチ再生ウェーハ生産能力(月産)

2024年	2025年	2026年	2027年
5万枚	5万枚	15万枚	20万枚

2024年の設備投資は、計画どおり進捗いたしました。
 2025年の日本、台湾の増産投資効果は、第3四半期から業績に寄与してくる見込みでございます。
 中国の再生ウェーハは、現在はまだ市場が立ち上がってないため、量産には至っておりませんが、
 2027年頃には市場ができると想定しておりますので、それに合わせて投資を実施していく計画です。

設備投資計画:プライムウェーハ事業

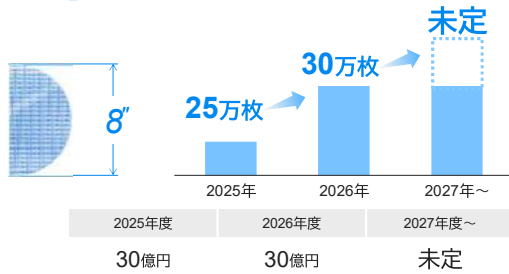


- 8インチプライムウェーハは、2025～2027年の間に月産25万枚から30万枚超の増産を予定
- 12インチプライムウェーハは、2025～2027年の間に月産11万枚から30万枚の増産を予定、2027年以降は30万枚を目指す

中国 8インチ

- 安定した量産体制の構築、生産効率の向上を目指す

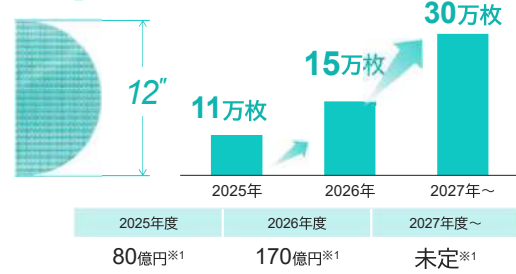
8インチプライムウェーハ生産能力(月産)



中国 12インチ

- 12インチプライムウェーハの生産能力増強を実施

12インチプライムウェーハ生産能力(月産)



※1 12インチ事業は持分法適用会社からの投資となります。

プライムウェーハ事業の設備投資計画についてです。

8インチは、2025年には25万枚へのキャパアップを実施いたします。既にお客様の需要状況が見えてきておりますので、それに合わせて投資の準備を開始しております。

12インチは、中国国内での半導体市況の動きを観察しながら進めている状況でございます。

2027年には中国の半導体内製化に向けた動きがより強くなると見ておりますので、それに合わせて当社も量産化できるよう計画を立てております。

M&Aターゲット

- ・事業規模拡大に向け、M&Aを実施
- ・「半導体」、「エネルギー」、「新規事業」がM&Aのターゲット

<M&Aターゲット領域>



<投資判断基準>

- ◆ 投資基準(ハードルレート)≒利回り14~20%
- ◆ シナジー効果を重視したターゲット選定
- ◆ 新規事業において成長性のある市場の選定

M&Aのターゲットについてです。
領域としては、半導体関連事業、エネルギー関連事業、そして新規事業を考えています。
また、投資判断としては、利回り20%程度、シナジー効果、成長性それぞれを鑑みて決定します。

M&A戦略 (M&A実施後の成果と今後)

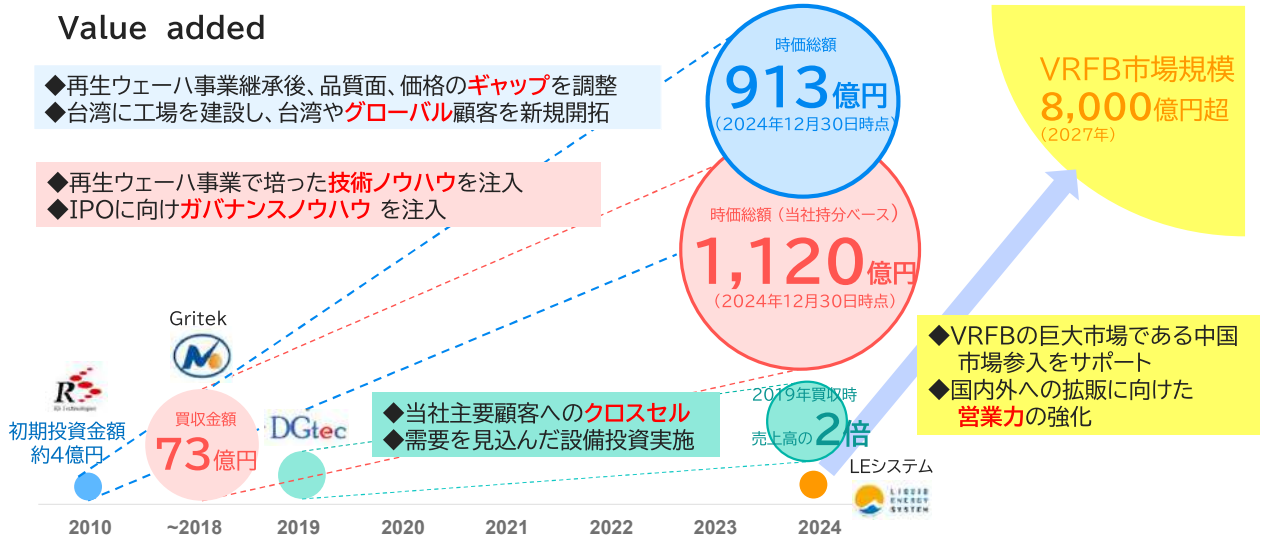


- 営業力、市場との対話力、シナジー効果を成長ドライバーとし短期間で価値向上を果たす
- 今後の事業拡大に向けPMIを強化し、当社グループの企業価値向上に貢献できる体制を構築

Value added

- ◆再生ウェーハ事業継承後、品質面、価格のギャップを調整
- ◆台湾に工場を建設し、台湾やグローバル顧客を新規開拓

- ◆再生ウェーハ事業で培った技術ノウハウを注入
- ◆IPOに向けガバナンスノウハウを注入



M&A施策の振り返りです。

当社グループは、M&Aを活用し成長してきました。

まず、RSテクノロジーズですが、ウェーハ再生事業撤退の情報を聞いてから検討を開始し、2010年に、約4億円で生産設備等の資産の譲渡を受けました。

その後、マーケットとの対話により再生ウェーハの品質、価格のギャップを解消しました。また、台湾、欧州、アメリカ等グローバル顧客を開拓しました。

結果、2024年12月末時点の当社時価総額は913億円となっております。

次にGritekです。

2018年に約70億円を投じ、その後、小規模な追加投資を行い、プライムウェーハ事業に参入しました。ウェーハ再生事業で培った技術と、RSテクノロジーズのIPO経験で得たガバナンスノウハウを注入し、垂直立上げを行いました。

結果、2024年12月末時点での当社持分時価総額は1,120億円となっております。

2019年に買収したDGテクノロジーズですが、本件は破綻した企業の買収です。

当社主要顧客へのクロスセルを行い約5年間で売上高を2倍にしました。

2023年に買収したLEシステムも非常にリーズナブルなディールでした。

これにより、成長が見込まれる約8,000億円のバナジウムレドックスフロー電池市場へのアクセスチケットを手に入れました。

また、2025年1月のリリースの通り、初の大規模出荷も行いました。

ここで申し上げたいのは、当社は効果的なM&Aができており、企業価値向上に再現性のあるノウハウを見いだせているという事です。

RS Technologies

の目指す世界

一步一步、着実に事業領域および販売地域を広げていく

事業

成長拡大

		日本	中国	アジア(中国以外)	欧米	
製 造	ウェーハ再生	●	●	●	●	
	プライムウェーハ	12in	○	●	○	○
		8in他	○	●	○	○
	半導体製造関連消耗財	●	●	●	●	
半導体製造	○	○	○	○		
エ ネ ル ギ ー 事 業	新規	○	○	○	○	
	バナジウムレドックスフローバッテリー	●	○	○	○	
商 社 機 能	製造装置	●	●	●	●	
	半導体・電子部品・消耗財	●	●	●	○	
	その他(太陽光など)	○	○	○	○	

● 現事業領域 ○ 地域拡大予定 ○ 今後進出の可能性有

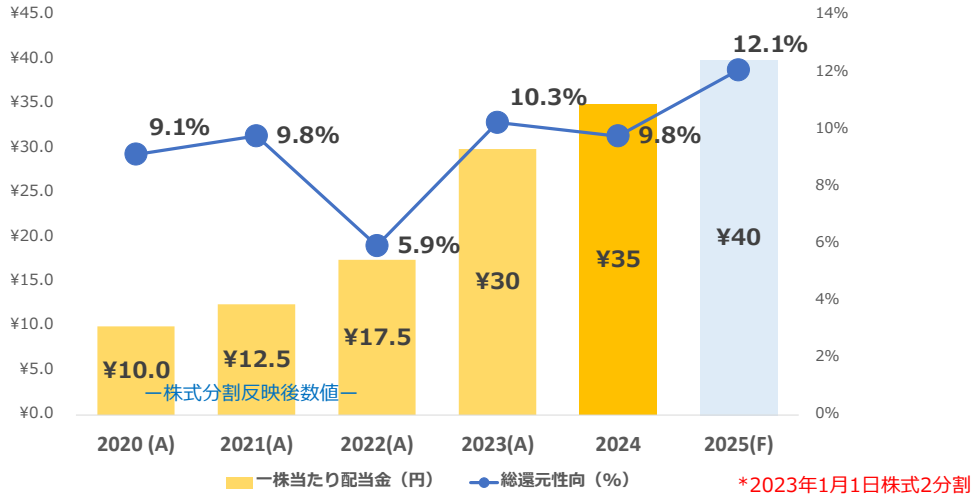
地域

今後はM&Aの実施や既存事業の成長により、規模拡大、企業価値向上に向けて一步一步着実に事業領域および販売領域を広げてまいります。

株主還元



•増配を継続、直近は設備投資やM&Aへの成長投資を優先



COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

株主還元についてです。
2024年12月期の一株当たり配当は35円となります。総還元性向は9.8%です。
2025年12月期はの総還元性向は12.1%を目指します。

新規事業

(LEシステム/RSPDH)

03

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

新規事業についてご説明いたします。

トータルエネルギーソリューション事業に新規参入



- 2023年12月、株式会社LEシステム(当社の100%子会社)が旧LEシステムよりバナジウムレドックスフロー電池(VRFB)用の電解液事業を継承
- 2025年1月からはこれまで積み上げた蓄電池の知見に加え、RSテクノロジーズのグループ総合力を活用し、トータルエネルギーソリューション事業へ参入

■ 新会社の概要



株式会社LEシステム

社名	株式会社LEシステム
設立	2023年10月13日(事業承継日:2023年12月)
事業内容	バナジウムレドックスフロー電池の電解液製造 蓄電事業を初めとしたエネルギーソリューション事業全般
所在地	東京都品川区大井1-47-1NTビル (株式会社RS Technologies内)
製造拠点	福島県双葉郡浪江町
資本金	30百万円
代表取締役	大澤 一生(2025年2月1日就任)

- 2023年12月より、旧LEシステムの事業を全面的に承継
- 旧LEシステムの基幹技術は日本で生まれた技術であり、株式会社INCJ(官民ファンド)の出資を含む多くの支援を受けてきた

■ LEシステムの強み

- 01** 高品質電解液の量産プロセスを確立済み
- 02** 海外含む多数の電池メーカーとのグローバルな協業体制
- 03** 独自技術によって低コストでの製造を実現(保有特許10件以上)
- 04** グループ力を活用、エネルギーソリューションをトータルで提供

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

まずは2023年12月に、事業承継によって参入したトータルエネルギーソリューション事業LEシステムについてです。

LEシステムは、1970年代より国の支援の下でバナジウムレドックスフロー電池、略称VRFBの研究、製造、開発並びに燃焼煤の廃棄物からバナジウムを取り出す技術の研究開発を一途に行ってきた会社であります。

世界的に需要が拡大しているVRFB市場では、LEシステムのような電解液製造に参入する企業も近年増えています。

ただ20年以上VRFB用電解液の開発を続けているのはLEシステムだけなので、技術力や品質には優位性を持っています。

とくに北米や中国ではこの技術を活用できるチャンスが多く存在することから、グローバルに強みを持つ当社では、市場シェアを獲得することができると見込んでおります。

また現在は、VRFB用電解液に特化したビジネスとなっておりますが、今後はエネルギーコスト最適化から蓄電所建設までをお客様に提案できるトータルソリューションプロバイダーとして、ワンストップサービスの提供を目指してまいります。

バナジウムレドックスフロー電池(VRFB)とは



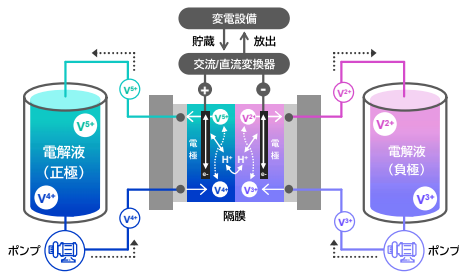
- VRFBは、バナジウム電解液を循環・化学反応させることで充電と放電を行う蓄電池。LEシステムでは、このバナジウム電解液を製造・供給している

主要用途

風力発電や太陽光発電等、大規模・大容量の定置式蓄電池としての活用

仕組み

他の蓄電池が電極の化学変化で充電と放電を行うのに対し、VRFBは電解液の化学変化(酸化還元)による充放電を実現



特徴

充電と放電回数に制限がなく劣化がないことから長期の安定稼働が可能であり、安全性も高く、再生エネルギーとの相性も良い

<p>高い安全性 不燃性電解液</p>	<p>拡張の自由度 充放電の時間を自由に設計可能</p>	<p>長寿命 充放電サイクルに制限がない</p>	<p>コストダウン 長期間運用がコスト面で有利に</p>	<p>非同期連携 再生エネルギーと相性が良い</p>
--------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------

VRFBは大容量の定置式蓄電池として高い安全性と安定供給が求められる風力・太陽光発電等に最適な特徴を有する

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

VRFBの特徴について説明いたします。

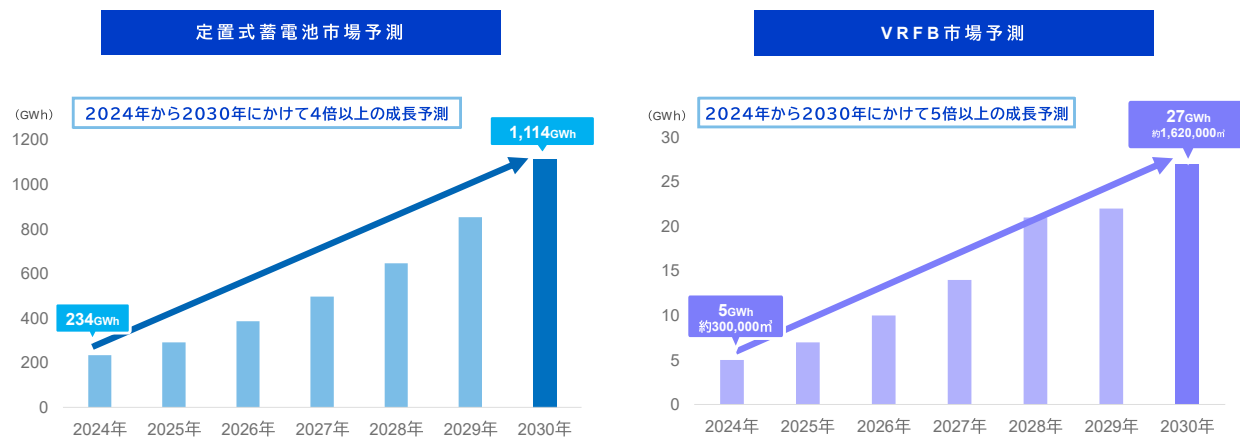
現在の蓄電池の主流である、リチウムイオン電池と比較した場合の、最も重要な特徴は「発火の危険がなく、安全性が高い」こと、そして「20年以上の長寿命」ということです。これはどちらも、リチウムでは実現できていない特徴です。

これらの特徴は風力発電・太陽光発電などの再生可能エネルギーと相性が良いとされています。

蓄電池市場グローバル予測



- 太陽光、風力等の再生可能エネルギー市場拡大を背景に、電力の需給調整用の「定置式蓄電池」需要が増加
- VRFBは、現在蓄電池市場で主流であるリチウム電池とに比較すると、「安全性」「長寿命」といった特徴があり、一定のシェアは維持され続けると予測



出所:世界銀行/国際復興銀行資料(BNEF、国際エネルギー機関、InteractAnalysis、WEFに基づく)

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

今後の拡大が見込める、定置式蓄電池とVRFBのグローバル市場についてです。

まず定置式蓄電池の市場ですが、こちらは2024年から2030年までに4倍以上の成長が予測されています。

定置式蓄電池にはVRFBの他、リチウムイオン電池なども含まれます。

VRFBには、安全性、長寿命などという特徴があるため今後も一定のシェアは維持され続けると予測されています。

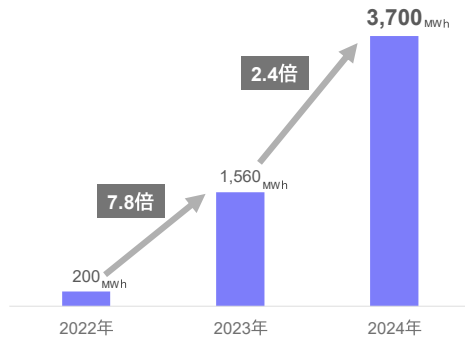
右側のグラフのようにVRFBの市場規模も2024年から2030年にかけて5倍以上の伸びが予測されています。

LEシステム(中国事業戦略)



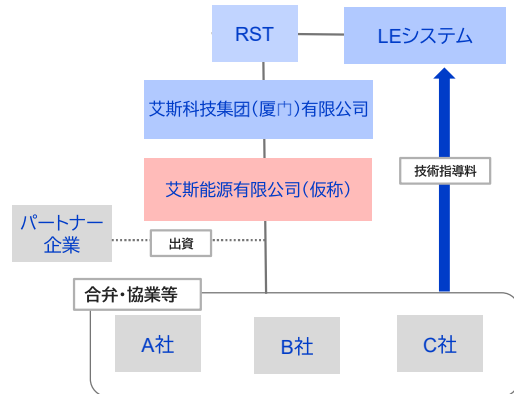
- ・2025年3月に中国のエネルギー関連孫会社「艾斯能源有限公司(仮称)」(RS Energy Co.,Ltd.)を設立予定
- ・パートナー企業との協業や合併を推進し、レドックスフロー電池の最大市場である中国国内に製造工場建設を検討
⇒当社からの持ち出しは総額15億円を計画

中国市場 VRFB用電解液公示入札動向



入札実績は年々大幅に増加
2026年には中国国内の製造工場にて量産化を目指す

中国事業戦略



COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

中国におけるLEシステムの戦略についてです。
レドックスフロー電池最大の市場である中国にマーケットインするために、まず2025年3月にエネルギー関連孫会社RS能源を設立する予定です。
そこから、中国のパートナー企業と合併や協業をを行い、製造工場を建設してまいります。
日本から中国に電解液を輸出すると、原料、製品それぞれの輸送コストなどの課題が発生しますので、中国に拠点を持つことは、中国市場に参入するためには非常に重要だと考えています。

LEシステム(日本事業戦略)



- 福島県浪江工場では、引き続きVRFB用電解液の製造販売を継続し、日本及び海外への出荷を行う
- VRFB用電解液ビジネスに加え、電力コスト最適化から蓄電所建設までをお客様に提案できるトータルソリューションプロバイダーとして、ワンストップサービスの提供を行う

【VRFB用電解液事業】

LEシステム浪江工場 国内外のセルメーカー

日本、欧州、北米、アジアの発電所などに
電解液+セルをシステム販売



【系統連系蓄電池事業】

- ☑ 用地開発
- ☑ 蓄電システム/電力販売
- ☑ 電解液販売
- ☑ 蓄電事業運営
- ☑ 電力コスト最適化コンサルティング

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

日本におけるLEシステムの戦略です。
日本では福島県双葉郡浪江町に製造拠点がございます。
今後はこの浪江工場での電解液製造に加え、系統連系蓄電池事業としてエネルギーコスト最適化から蓄電所建設までをご提供し、
トータルエネルギーソリューションカンパニーを目指してまいります。

艾索精密部件(惠州)有限公司(RSPDH)



- 艾索精密部件(惠州)有限公司を2024年12月30日に連結子会社化
- 既存事業である光ピックアップモジュールに加え、新たに車載カメラモジュール事業を立ち上げ、更なる事業拡大を目指す
- 中国マーケットにおける当社の強みを活かし、販路拡大を見込む

< 艾索精密部件(惠州)有限公司の概要 >

名称	艾索精密部件(惠州)有限公司(略称、RSPDH)
設立年月日	1995年11月20日
資本金	555百万元
事業内容	光学ピックアップモジュール・ 車載カメラモジュールの製造・販売
所在地	広東省惠州仲恺高新区惠环町惠风東一路9号、11号



COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

もう一つの新規事業として、2024年12月にRSPDHを連結子会社化し、光学ピックアップモジュールと車載カメラモジュールの製造・販売事業に参入いたしました。
今後当社では車載カメラモジュール事業を中国に広めていきたく考えております。

会社概要

04

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

会社概要についてです。

会社概要



- ・ウエーハ再生事業で世界市場シェア33%の**トップ企業**^{※1}
- ・中国中央企業^{※2}との合併事業でプライムウエーハ事業に進出
- ・M&Aによりシナジーの期待できる周辺事業領域に事業を拡大

社名	株式会社RS Technologies
設立	2010年12月10日
経営理念	「地球環境を大切に、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」
事業内容	<ul style="list-style-type: none">・ シリコンウエーハの再生加工・販売・ プライムウエーハの製造販売・ 半導体製造装置向け消耗部材の製造・販売・ 超音波映像装置の販売・ 電子部品の販売・ エネルギー関連事業 等
本社所在地	東京都品川区大井1-47-1 NTビル
製造拠点	宮城県、茨城県、福島県、台湾、中国
資本金	5,643百万円(2024年12月末時点)
代表取締役	方永義

主な
連結
子
会
社

有研半導体硅材料股份公司 GRITEK (北京)	登録資本 10億人民幣 出資比率 40.21% ^{※3} 上場 上海証券取引所 科创板
---------------------------------------	---

艾爾斯半導体股份有限公司 (台湾)	資本金 NT \$300 million 出資比率 100%
----------------------	-----------------------------------

株式会社 DG Technologies	資本金 100百万円 出資比率 100%
----------------------	-------------------------

株式会社 ユニオンエレクトロニクスソリューション	資本金 27百万円 出資比率 100%
-----------------------------	------------------------

株式会社LEシステム	資本金 555百万円 出資比率 100%
------------	-------------------------

※1 SEMIデータに基づき弊社にて推計
※2 国有企業のうち、中央政府の管理監督を受ける企業
※3 2024年12月末現在

当社の会社概要になります。設立は2010年12月10日です。
「地球環境を大切に、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する」という経営理念の下で事業を進めております。

主な連結子会社は、中国にてプライムウエーハ事業を展開するGritek、台湾にてウエーハ再生事業を展開するRS台湾、宮城県と茨城県にてエッチング装置向け消耗部材の製造販売を行うDGテクノロジーズ、商社ビジネスを展開するユニオンエレクトロニクスソリューション、トータルエネルギーソリューション事業を展開するLEシステムです。
直近では2024年12月に光学ピックアップモジュールと車載カメラモジュールの製造販売を展開するRSPDHを連結子会社化いたしました。

当社の特徴としては、ウエーハ再生事業で世界市場シェア33%のトップ企業であること、中国の中央企業との合併事業でプライムウエーハ事業に進出したこと、M&Aによりシナジーの期待できる周辺領域に事業拡大を進めていることがあげられます。

現在のRS Technologies

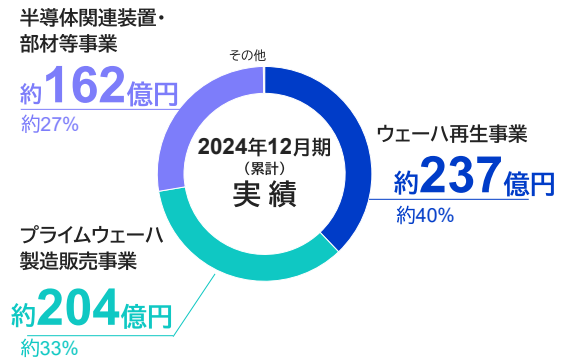


- ・ウエーハ再生事業+プライムウエーハ事業の総合ウエーハメーカー
- ・半導体関連装置・部材等事業など事業領域を拡大
- ・ウエーハ再生事業はグローバルシェアNo1、プライムウエーハ事業では中国国内向けを中心に事業を展開

連結売上高および営業利益



セグメント別売上高



COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

左のグラフは連結売上高と営業利益の推移となります。
2024年12月期は売上高592億円、営業利益は131億円といった結果となりました。
2015年から2024年までの間に売上高、営業利益は10倍以上に成長しております。

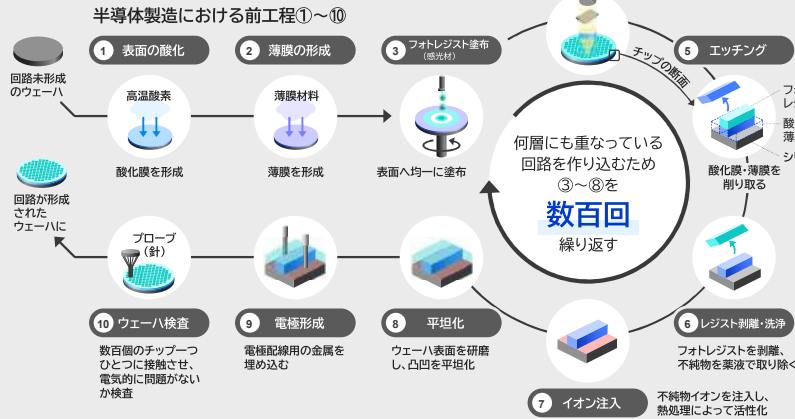
右側がセグメント別の売上高になります。コア事業となるウエーハ再生事業が約40%を占めており、次いでプライムウエーハ事業が約33%、半導体関連装置・部材等事業が約27%を占めております。

再生ウェーハとは



- 再生ウェーハとは、主に半導体製造において使用されるテストウェーハを再生加工したウェーハのこと
- 再生したウェーハは繰り返し使用されるが、当社独自技術では、10回以上のリサイクルも可能であり、環境負荷軽減に加え、半導体メーカーの**コストダウン**にも貢献

半導体メーカー



当社

- ほぼ全ての工程で使用される
 - モニターウェーハ(用途:プロセスや加工精度の評価)
 - ダミーウェーハ(用途:精密加工の安定性向上)
- 当社はそれらを再生し、半導体メーカーへお戻ししている

再生加工(再利用できる状態にクリーニング)

半導体製造のためには、ウェーハの再生が必要不可欠

使用済みのウェーハを回収

出荷

顧客資産を加工

当社の主軸であるウェーハ再生事業についてです。

まず再生ウェーハがどういうものかという、主に半導体製造において使用されるテストウェーハを再生加工したウェーハのことになります。

半導体製造では、シリコンウェーハ上に半導体の回路を作ることになります。この回路を形成する、いわゆる前工程と位置づけされる工場が当社の主要なお客様になります。

新品の真っさらなウェーハから、ICの回路がウェーハ上に形成されるまでは、少ないものでも500プロセス、最新の複雑な半導体になりますと2000～3000ものプロセスを経てICが形成されると言われています。製造期間としては数か月にもおよぶとても長いプロセスが、半導体の前工程で行われているということになります。

当社で再生加工されているウェーハは、このプロセスの中でテストウェーハと言われるモニターウェーハやダミーウェーハであり、これらが再生の元になります。

こういったものを半導体工場から預かり、また新品の状態に戻す加工を行います。新品と同様な品質に再生加工をした後に、もう一度半導体工場にお戻しして、同じ用途でまた使っていただくことをしているのが再生ウェーハです。

使ったらまた当社に送っていただき、また再生するというのを何度も何度も繰り返して使われます。再生ウェーハは10回以上再生し使われているものもあると思います。

テストウェーハをリサイクルすることは、環境負荷軽減に加えて、お客様である半導体メーカーのコストダウンにつながります。毎回新品のテストウェーハを買って使うより、再生ウェーハを何度もリサイクルして使うほうが安価なため、非常にニーズが高い仕事となっております。

ウェーハ再生事業について



・再生ウェーハ業界におけるグローバルサプライヤーとして、継続的な業績拡大を実現

市場の
特徴

半導体業界の継続的な成長

世界の半導体市場規模は、2023年から2030年にかけてCAGR:約10%で成長し、2030年には**1兆米ドル**に達すると予測されている※1

※1出所:SEMIジャパン(Semiconductor Market Forecast)



景気変動に強い

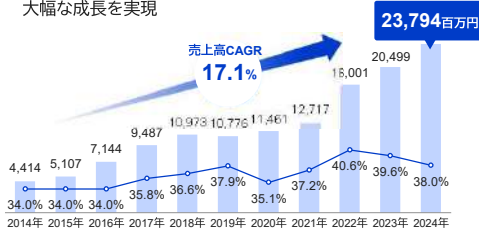
- ・製造装置の立上げ等多用途に利用される
 - ・不況時に顧客のコスト意識が高まると、再生ウェーハ投入量が増える
- シリコンサイクルの影響を受けにくい

今後も継続的な
成長が見込める

実績

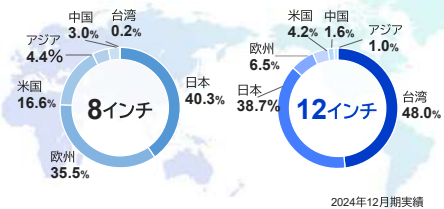
業績推移

- ・製造拠点の拡大等、積極的な生産能力の拡充によって (百万円)
大幅な成長を実現



地域別出荷構成

- ・日本・台湾・欧州・北米と幅広い出荷先を確保
- ・地域分散、業種分散によってリスクヘッジも図っている



ウェーハ再生事業の事業環境についてです。

まず世界の半導体市場の規模は、2023年から2030年にかけて年平均約10%成長すると言われており、半導体業界が継続的な成長市場であるということが言えます。

そしてウェーハ再生事業は、経済状況に左右されない安定した事業であります。

これは、再生ウェーハの加工賃が新品ウェーハの購入に比べて安価なので、景気が悪くなるとお客様は高い新品ウェーハの購入を控え、可能な限り安価な再生ウェーハを使おうという動きになるためです。

たとえ不況であっても工場が閉鎖しない限り、ラインの稼働はとまらないためテストウェーハの需要がなくなることはありません。

半導体市場の景気の波は非常に大きいですが、当社はそれを受けにくい事業だということが言えます。

右下の円グラフでは、8インチ、12インチの地域別出荷構成を示していますが、現在当社のお客様の9割近くは12インチとなっております。

再生市場における当社のシェア



再生市場での当社のシェア拡大

■ 12インチ再生市場における当社シェア

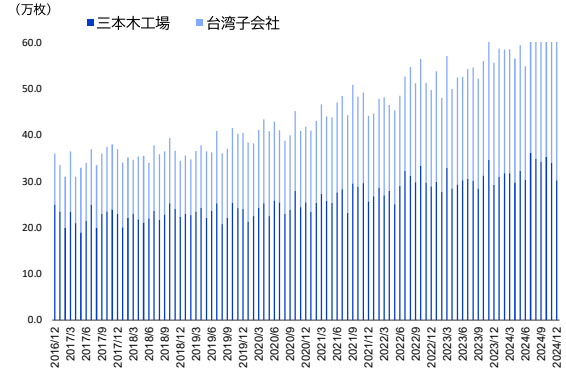


年	2015下期	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
生産能力	24万枚	28万枚	30万枚	34万枚	40万枚	42万枚	46万枚	55万枚	59万枚	63万枚
シェア	24%	29%	30%	31%	33%	33%	33%	33%	33%	33%

SEMデータに基づき弊社にて推計

三本木工場と台湾子会社の出荷推移

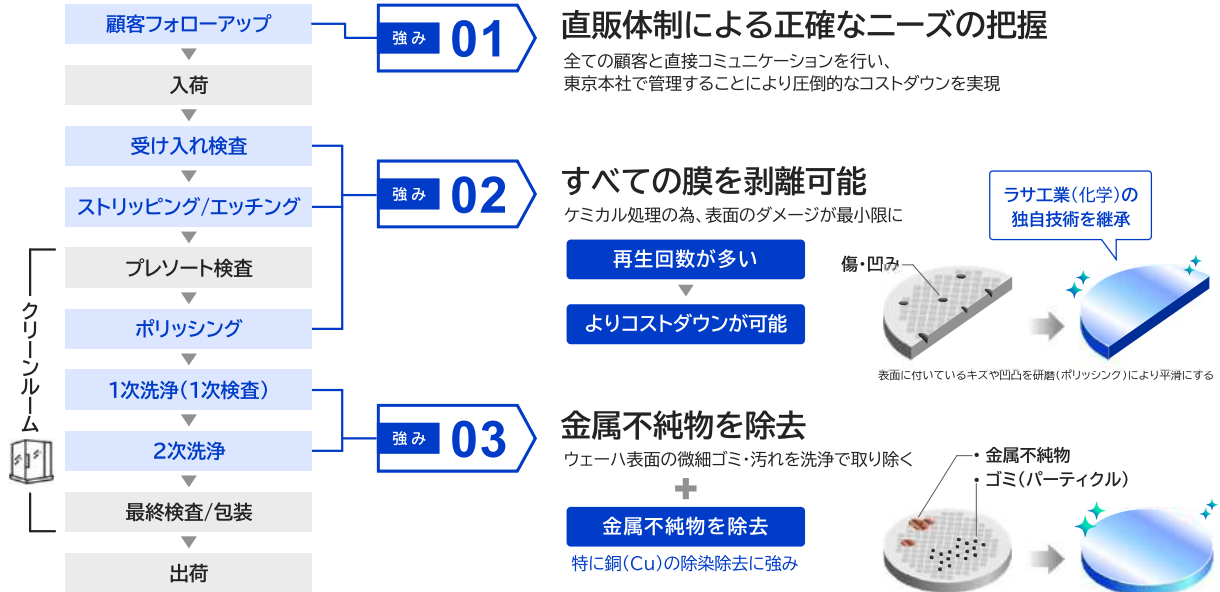
■ 三本木工場と台湾子会社の12インチウエーハ出荷枚数推移



12インチの再生市場において当社は、グローバルシェア1位で、約33%を占めています。次いで日本のA社、B社、最近では台湾勢もある程度の割合を占めています。世界の再生市場の約8割をこの6社で分散していますので、寡占市場といえると思います。

右側は三本木と台湾工場の12インチウエーハの出荷枚数の推移で、これは年々順調に右肩上がりに推移していることが分かります。

当社再生の強み



当社再生ビジネスの強みとしては、まず営業体制がございませう。当社では海外のお客様も含めて基本的には全体的お客様に代理店を介さない直接営業をしています。

お客様のニーズを直接聞いて速やかに対応する体制が特に海外市場の確保という点では強みになります。

左側の工程は再生プロセスになりますが、当社にお客様から送られてくるウェーハには、半導体の材料になるいろいろな物質が膜状にウェーハに付着しています。いかなる膜であっても、いかなる素材であってもきれいに取り除くことができるのが当社の強みであります。特徴としては、基本的に化学薬品を使って、表面のダメージが最小限になるように丁寧に膜取りを行い、その後の研磨数を減らすということを行っております。研磨数が少ないということは、ウェーハをリサイクルできる回数が多くなるため、よりお客様のコストダウンにつながり、再生ウェーハのニーズが高くなります。

強みの3番目としては、金属不純物を高レベルで除去できることです。再生ウェーハの最終品質としては、ウェーハ表面の異物や金属汚染をきれいに取り除くことが重要になりますが、これを当社独自の洗浄プロセスで他社よりもきれいに取り除く技術があると自負しております。特に銅という物質は取り扱いが厄介な元素ですが、これを取り除く技術やプロセスも当社独自のものであり、非常に高いレベルのクリーン度を誇る品質を提供できることが強みとなります。

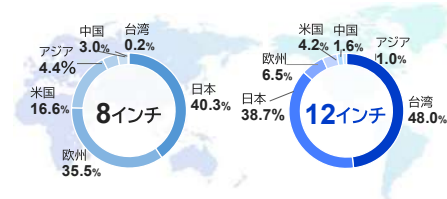
出荷先構成



- 台湾工場は、大手台湾ファウンドリメーカーの需要に対応し、三本木工場は、台湾以外の世界各国に対応
- アプリケーションは、CMOS、ロジック、メモリ、パワーと分散し、リスクヘッジを図っている

地域別出荷構成

日本・台湾・欧州・北米と幅広い出荷先を確保

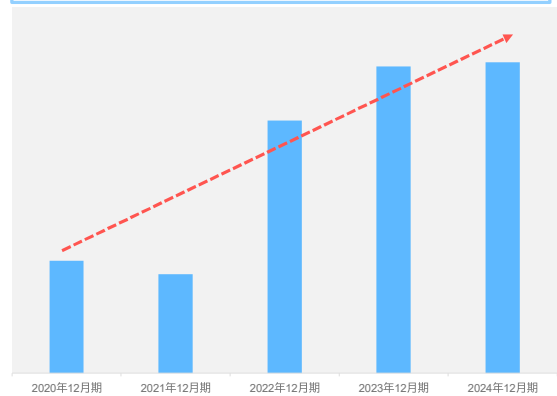


12インチ地域別割合推移

	2020/12期	2021/12期	2022/12期	2023/12期	2024/12期
日本	32.6%	34.0%	35.4%	26.4%	38.7%
台湾	40.4%	47.0%	47.7%	53.2%	48.0%
米国	13.3%	4.5%	2.8%	4.9%	4.2%
欧州	6.1%	6.3%	7.4%	11.8%	6.5%
アジア	7.7%	8.0%	7.0%	4.0%	2.5%

RS台湾 主要顧客(大手台湾ファウンドリメーカー)売上高

売上高は5年で約2.8倍に増加



左の地域別構成の推移のとおり、常に地域は分散しており、アプリケーションもCMOS、ロジック、メモリ、パワーと幅広く分散することでリスクヘッジを図っております。

台湾への出荷は、年々増加傾向となっており、これは大手台湾ファウンドリメーカーの増産に伴い、当社への再生ウェーハの受注数も増加してきていることが分かります。

左のグラフのとおり、RS台湾における大手台湾ファウンドリメーカーの売上高は5年で約2.8倍に増加しており、同社内の再生ウェーハ委託先のシェアは1位を維持しております。

ウェーハ再生事業の需要先: 12インチ半導体“新”工場

- 世界市場では、中欧米日等で12インチ半導体新工場が建設中
- 当社は、日本、台湾及び中国への設備投資により、新たな再生ウェーハ需要へ対応



注:RST調べ

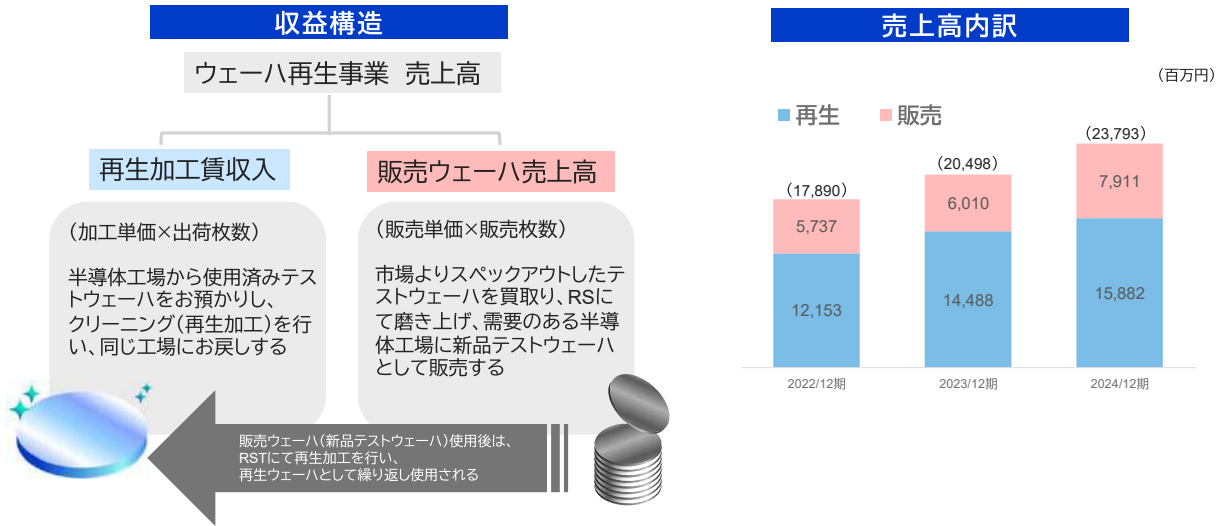
COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 34

これから新しく建設される予定の12インチの半導体新工場をエリアごとに示しています。半導体工場が新設されるということは、再生ウェーハへの需要もますます高まるということが言えます。当社もこの動きに合わせて設備投資をし、需要を取り込む体制を進めております。

売上高構成



- ・ セグメント内再生ウェーハ、販売ウェーハの割合は、7:3程度が継続
- ・ 2024年は販売ウェーハの新規受注先獲得により、販売ウェーハの売上高が上昇



ウェーハ再生事業の売上高構成です。

このセグメントは、再生ウェーハの加工賃収入と、販売ウェーハの売上高で構成されています。

販売ウェーハとは、市場よりスペックアウトしたテストウェーハを仕入れ、当社にて研磨加工後、需要のある半導体工場に新品テストウェーハとして販売しているものです。

販売した新品テストウェーハは、1度使用されたあとは、再生ウェーハとして当社に再生の依頼が入り、繰り返し使用していただくことになります。

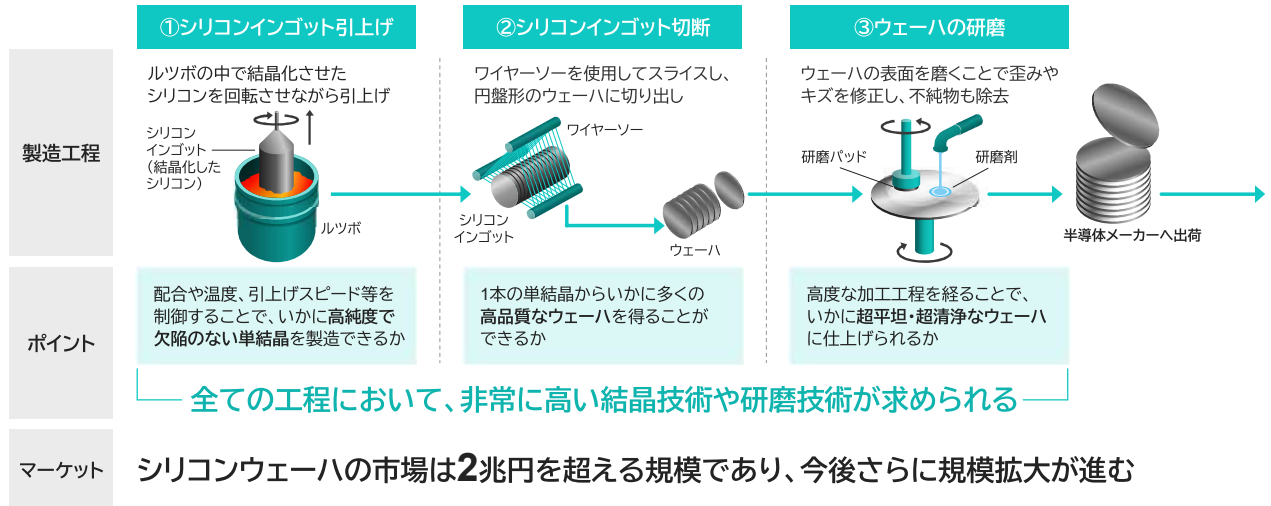
半導体工場の新設や新ライン立ち上げ時には、新品テストウェーハの需要が特需として増加します。2024年は、日本や米国の新工場立ち上げ用途として数量が増加しましたが、今後それは再生ウェーハとしてまた需要が繰り返されます。

再生ウェーハと販売ウェーハの売上高割合は、7対3程度となっております。

プライムウェーハとは



- ・プライムウェーハとは、半導体の基板材料であるシリコンウェーハのこと
- ・イレブンナイン(純度99.99999999%)のシリコンを用いており、非常に高い平坦度のウェーハに加工する事業



次にプライムウェーハについてお話しさせていただきます。

製造では、インゴットと言われるシリコンの結晶を引き上げ、それからインゴットを切断してウェーハ状にし、研磨、洗浄などの加工をして新品のウェーハが作られます。

プライムウェーハの市場は2兆円を超える規模であり、今後さらに規模拡大が進むと見込まれております。

プライムウェーハビジネスへの進出について



・中国中央企業※1の有研科技集团有限公司(Grinm)と事業会社である有研半導体材料有限公司※2(Gritek)を設立

※1 国有企業のうち、中央政府の管理監督を受ける企業
 ※2 現:有研半導体硅材料股份公司



有研科技集团有限公司
(Grinm)

1952年創立:中国の非鉄金属分野で最大の国有研究機関
 約4,100名の従業員のうち、約2,000人の研究者が在籍

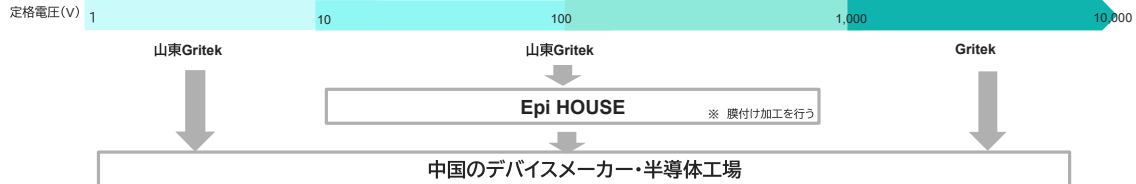
当社は中国の非鉄金属分野で最大の国有研究機関であるGRINMと合併しGritekを設立いたしました。
 こちらではGRINMの技術力と人材力、そして当社再生ウェーハの研磨、洗浄の技術力を活用しています。
 将来的にはRSテクノロジーズの販売網を活用しグローバルに販売する戦略です。

8インチプライムウェーハ商流と売上構成イメージ



- Gritekは、プライムウェーハ市場の中ではニッチな分野を強みとするため、高い利益率が継続
- 中国政府のの経済活性化に向けた取組みの1つである家電購入時の補助金を追い風に、パワー半導体需要は増加傾向

■Gritek 8インチウェーハの主な商流イメージ



■使用用途イメージ



■Gritek 8インチウェーハの売上高構成イメージ(2024年12月期)



こちらはGritekの8インチプライムウェーハの商流と売上高構成です。

プライムウェーハの需要割合は約8割が12インチです。

そのような中、Gritekは8インチを主流に製造しており、その中でも特に車載、インバーター、産業機器など低抵抗の分野に強みがござます。

この分野には設備投資や研究開発を強化してまいりましたので、価格、技術力ともに優位性を持っております。

そしてこの分野はプライムウェーハ市場のなかでもニッチな分野と言えますので、市況環境に左右されにくく常に一定の需要があること、そして高い利益率を維持しやすいという特徴がございます。

これは中国の8インチ市場の特徴といえますが、自社で製造したウェーハをエピハウスに販売し、エピハウスで膜付けをしたあとにエンドユーザーに販売しています。

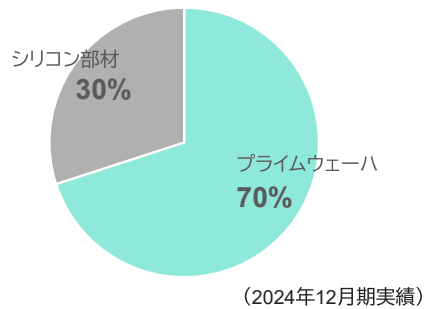
そのためGritekのお客様の一部はエピハウスということになります。

売上高構成



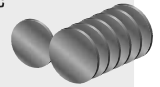
- 中国の半導体市況の回復基調を背景に、2024年度から、プライムウェーハ比率が上昇

プライムウェーハ事業売上構成イメージ

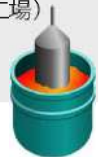


商品概要

- プライムウェーハ 5、6、8インチ合計
- ・中国国内のEpi HOUSEや半導体メーカーに販売



- シリコン部材(エッチング装置の消耗部材)
- ・グローバルの加工メーカーへ販売
(エンドユーザーはエッチング装置メーカーや半導体工場)



プライムウェーハ事業の売上高構成です。

さきほどご説明したプライムウェーハの他に、シリコン部材の製造販売もこのセグメントに含まれております。割合としては、変動はあるものの2024年は約3割がシリコン部材の売上高となりました。

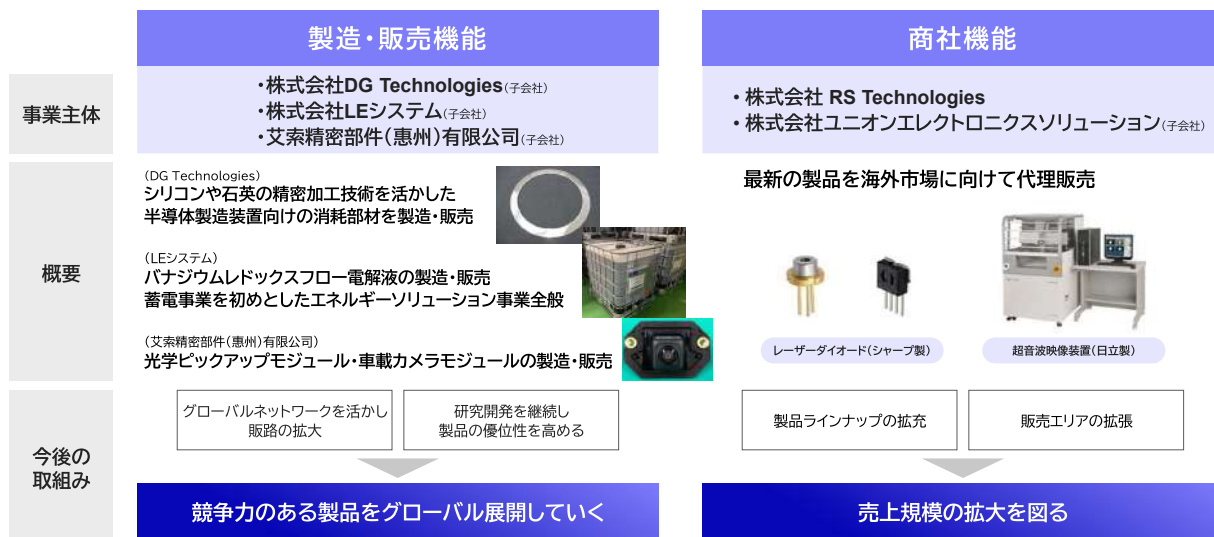
Gritekのシリコン部材は、エッチング装置の消耗部材に加工されるため、お客様は加工メーカーとなり、そこからエンドユーザーであるエッチング装置メーカーや半導体工場に販売されます。

プライムウェーハは中国で製造し、主に中国国内に販売しております。シリコン部材は中国で製造し、中国とそれ以外のグローバルに販売しております。

半導体関連装置・部材等事業について



・製造販売機能と商社機能を展開するセグメント



半導体関連装置・部材等事業についてです。
 このセグメントには製造販売機能と、商社機能の2つが含まれます。
 製造販売機能では、子会社であるDGテクノロジーズでのシリコンや石英のエッチング装置用消耗部材の製造販売が含まれております。
 今後はLEシステムやRSPDHの事業も含まれてまいります。

商社機能では、RSテクノロジーズと子会社であるユニオンエレクトロニクスソリューションでの半導体検査装置や電子部品などの代理販売が含まれます。

地域戦略

日本・北米・欧州

三本木工場(日本旗艦工場)が北米、欧州、日本等を中心にカバー

ウェーハ再生事業:米国の政権交代による関税影響は軽微

米中摩擦の影響を回避するため、米中間の取引は行わない戦略

中国

現時点でプライムウェーハは中国国内を中心に販売

台湾

ファウンドリーの集積地である台湾地域内は台湾工場でカバー

COPYRIGHT©RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 41

デカップリング戦略も引き続き行っており、ウェーハ再生事業では、中国、台湾はそれぞれの国内でビジネスを完結することができており、それ以外の欧米や日本、アジアを三本木工場でカバーしています。

プライムウェーハ事業においては、中国で製造し、中国を中心に販売しております。

そのため仮に米中摩擦が深刻化した場合でも、当社事業およびお客様への影響を最小限にできる体制を構築しつつございます。

また、ウェーハ再生事業では、現在関税はかかっておりませんが、今後米国の政権交代による変化があった際も影響は軽微であると考えております。

説明は以上となります。

ご清聴ありがとうございました。

【質疑応答】

Q1：中期経営計画のトップラインは、2025年から大きく伸びていると思います。今期、セグメント別にどの程度増加するかイメージなどを教えてください。（決算説明資料 P10）

遠藤：ウェーハ再生事業については、市場の成長に合わせて、5%程度の成長を想定しています。2027年からは新しく三本木の第7工場が稼働しますので、割合的にはもう少し多くなると思います。

プライムウェーハ事業については、P15のとおり、8インチウェーハの生産能力を現在の月産18万枚から月産25万枚へのキャパアップを行い、事業成長につなげる計画です。なお、増産効果は下期から業績寄与する想定です。

新規事業のLEシステムとRSPDHは、今期から中期経営計画に含まれています。今期の規模としては、LEシステムが10億円程度、RSPDHは100億円程度を予測しています。

Q2：再生ウェーハにおける御社独自の技術力について、グローバルシェア約33%の競争力があるとのことでした。御社の場合、ラサ工業から引き継いだ技術により、あまり研磨に頼らず剥離できるため、再生できる回数が他社より多いことは理解できました。それが、御社の価格競争力にどのように結びついているのか教えてください。（決算説明資料 P34）

遠藤：当社技術の特徴として、化学薬品を使っていかに少ないダメージで膜を取り、研磨の負荷を減らすかがポイントになります。研磨は、設備を導入するための大きな投資が必要になるだけでなく、ボトルネックになりやすい工程でもあります。その研磨量を減らすことで、研磨時間が短くなり、効率が上がるというメリットもあります。したがって、設備投資が減ること、そして効率が良いことが当社の価格競争力につながっていると言えます。台湾工場と三本木工場を合わせて月産50万枚以上の12インチウェーハを製造していますので、このボリュームも大きなコストダウンにつながっています。

Q3：他社では御社と同じような再生ウェーハのプロセスはできないのでしょうか？ 研磨に頼る比率を下げ、薬剤で剥離すれば良いだけですから、なぜ他社が追いつけないのかと思ってしまいます。

遠藤：当社の前身は化学薬品を扱う会社で、1985年から当該事業を行ってきました。技術力がない、あるいは後から参入した場合は機械研磨で膜を削る方向に行きやすいですが、当社は化学薬品でいかにダメージなく取るかということにこだわり、その技術を極めてきました。このような歴史や経験が当社独自の特徴だと考えています。

Q4：再生ウェーハ製造のリードタイムと歩留まりはどれくらいのイメージですか？インチによって異なると思いますし、どれくらい工程を重ねるかによっても違うと思いますが、1枚当たりの歩留まりとリードタイムのイメージを教えてください。

遠藤：お客様からウェーハをお預かりし、お返しするまでは平均3週間とお伝えしています。これは待機時間も考慮した日数となっています。

歩留まりについては、ウェーハは再生を繰り返していくと薄くなっていきますので、どうしてもお客様起因でどこかで頭打ちになってしまいます。それを考慮しても、歩留まりは90%以上です。

Q5：ウェーハ再生事業における増産投資計画の進捗と三本木第7工場稼働による減価償却費の見通しを教えてください。（決算説明資料 P14、P49）

遠藤：現在開示している2027年までの増産計画と2027年からの第七工場稼働の計画は、現在問題なく進捗しています。

第7工場への投資約150億円の減価償却費は、装置等購入のタイミングによって2026年に一部計上される可能性はございますが、現時点で明確になっている情報はございません。

Q6：中国でもプライムウェーハの内製化が進んでいるとのことですが、今後、御社のプライムウェーハ事業の競争相手となる可能性をどのように見えていますか？もし競争相手となる場合は、どのように戦っていくのかを教えてください。

方：現在、中国最大手と言われるプライムウェーハメーカーの1社を一番の競合であると認識しています。こちらの会社は当社にとって再生ウェーハのお客様でもあり、プライムウェーハの競合でもあります。

こちらを強敵と考えているのは、技術力も生産規模も急速に拡大しているためです。当社も生産能力や技術力向上等の投資を行いマーケットシェア獲得の準備を進めています。

Q7：Gritek に対する持分ベースの時価総額のほうが、御社の時価総額を上回っており、方社長のお話を聞いていると、このことを問題視しているように感じます。グループの資産価値を時価総額に反映するために、どのようなことを考えていますか？（決算説明資料 P17）

方：時価総額が親子で逆転している件について、株主の皆様からのご意見は真摯に受け止めており、私もこの数字に対しては課題感を持っています。今後、IR活動を強化すること、そしてGritekの資産を上手く活用することで、当社時価総額を高めていきたいと考えています。

また、子会社であるDG Technologiesの当社保有株式の70%をGritekに譲渡し、中国マーケットの開拓、その他のグローバルでのシェアアップを図ることも検討しています。Gritekが世界のマーケットと対話できるようになることで、当社の資産価値も上がっていくのでは

ないかと考えています。今後も、このような形で Gritek の資産を活用しながら、当社の資産価値を向上させていきたいと考えております。

Q8：2024年12月20日開示の会社分割による持株会社体制移行の件は、時価総額向上施策とは関係ないと理解すればよろしいですか？

河路：当社は、2024年12月に連結子会社化した RSPDH の事業等により多角的な経営戦略をとっています。そのような中で、この持株会社体制移行が、選択と集中について早期に適切に対応できる体制構築につながり、結果として当社の資産価値向上、時価総額向上に繋がると考えています。

Q9：LE システム日本事業では、VRFB 用電解液を日本、欧州、北米、アジアの発電所などに販売していく戦略だと記載がありました。2025年1月にスペインの大規模蓄電所向けへの出荷を開示されていますが、欧州の需要は高いのでしょうか？また、LE システムの VRFB 用電解液が選ばれた理由が分かれば教えてください。（決算説明資料 P25）

遠藤：欧州における VRFB 用電解液の需要は今後も高まると考えています。欧州はサステナビリティやカーボンニュートラルのキーワードからも意識の高い企業が多数ございますので、引き続き注力してまいります。今回のスペインの大規模蓄電所向けへ受注に関しては、電解液の品質が最も評価されたポイントでございました。

Q10：新規事業 RSPDH の車載カメラモジュール市場は競争が激しいですが、今後どのように差別化し、伸ばしていく戦略ですか？

方：ご指摘のとおり、車載カメラモジュール市場は競争が非常に激しいと認識しています。しかし、当社は中国ビジネスに強みがありますので、これまで参入してきていなかった中国ローカルの車載カメラモジュール市場に、当社なら新規参入できると見込みました。今後は、日系企業をはじめ、グローバルの車載関係への供給も継続し、加えてドローンや民生品にも供給していく予定です。

Q11：2024年のグループ会社からの受取配当金はどれくらいあるのでしょうか？ また、その内訳を教えてください。

河路：2024年12月期の受取配当金は約5億円です。内訳の詳細については割愛しますが、中国、台湾、日本それぞれの子会社から留保利益に相当する部分をいただいています。